

仕 様 書

1. 件名

チップ個片化レーザー用精密空調装置

2. 研究の概要

産業技術総合研究所分析計測標準研究部門（以下、「産総研」という。）では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）受託「経済安全保障重要技術育成プログラム」の一環として、半導体デバイスにおける非破壊的な高分解能 X 線ハイブリッドイメージング技術の開発研究を行っている。

3. 装置の概要

本装置は、半導体デバイスを高分解能かつ高感度にイメージングするための中赤外イメージング装置の一部として運用する空調システムであり、精密な環境下での動作を必要とするレーザーを安定的に運用することを可能にする装置である。

4. 装置の基本構成

4-1. チップ個片化レーザー用精密空調装置

5. 基本構成別仕様

5-1. チップ個片化レーザー用精密空調装置

- ① 温度調整範囲：20 から 25℃までの全範囲を含むこと。
- ② 温度精度：0.1℃以下であること。
- ③ 最大冷却能力：12kW 以上であること。
- ④ 処理風量：25 m³/min 以上であること。
- ⑤ 設置箇所寸法：高さ 2500mm 以下、奥行き 900mm 以下、幅 2600mm 以下であること。
- ⑥ 必要電力特性：単相または三相、100V または 200V、1 つの分岐ブレーカーあたり 50A 以下、2 つ以下の分岐ブレーカーを利用すること。
- ⑦ 騒音：78dB 以下であること。

6. 納品確認試験

本装置を搬入、据付、調整の後、調達請求者の立会いのもと、納品確認試験を行い、仕様書を満たしていることを確認したうえで、装置が正常に作動することを確認し、その結果を納品確認試験成績表として納入すること。ただし、配電盤への繋ぎこみ作業については、産総研関係者が執り行う。

7. 納入物品

- 7-1. チップ個片化レーザー用精密空調装置 一式
- 7-2. 取扱説明書 1部（紙媒体）
- 7-3. 納品確認試験成績表 1部（紙媒体）
- 7-4. 構成品一覧表 1部（紙媒体）

8. 納入の完了

本装置は、「7. 納入物品」に記載された納入物品が過不足なく納入され、仕様書を満たしていることを確認して、納入の完了とする。

9. 納入期限及び納入場所

納入期限：2026年2月27日

納入場所：茨城県つくば市梅園1-1-1

産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門

つくばセンター 中央事業所2群 2-1D棟 01115室

10. 付帯事項

- ・ 納入時には、本装置の安全操作及び一般的な保守について説明を行うこと。
- ・ 納入された装置における能力内の使用中に発生した納入の完了後1年以内の故障については、その修理、調整等責任をもって無償で行うこと。
- ・ 本仕様書の技術的内容及び知り得た情報に関しては、守秘義務を負うものとする。
- ・ 本仕様書の技術的内容に関する質問等については、調達請求者と協議すること。また、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、調達担当者と協議のうえ決定する。
- ・ グリーン購入法適用品の場合は、グリーン購入法に定められた判断基準を満たすものを納入すること。